

IR 事業説明会

取締役 兼 執行役員専務 戦略本部長

木村 隆秀

2017年6月7日

古河電気工業株式会社

将来情報についての注意事項

この資料に記載されております売上高及び利益等の計画のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、当社グループの各事業に関する業界の動向についての見通しを含む経済状況、ならびに為替レートの変動その他の業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報をもとにした当社グループの仮定及び判断に基づく見通しを前提としております。

これら将来予想に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性が内在しており、例として以下のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。

- ・米国、欧州、日本その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費及び企業による設備投資の動向
- ・米ドル、ユーロ、アジア諸国の各通貨の為替相場の変動
- ・急速な技術革新と当社グループの対応能力
- ・財務的、経営的、環境的な諸前提の変動
- ・諸外国による現在及び将来の貿易規制等
- ・当社グループが所有する有価証券等の時価の変動

従いまして、実際の売上高及び利益等と、この資料に記載されております計画とは大きく異なる場合があることをご承知おき下さい。なお、当社グループは、この資料の本リリース後においても、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。

著作権等について

この資料のいかなる部分についてもその著作権その他一切の権利は、古河電気工業株式会社に帰属しており、あらゆる方法を問わず、無断で複製または転用することを禁止します。

古河電気工業株式会社

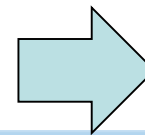
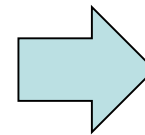
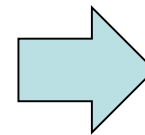
20中計目標達成に向けて

	2016年度 実績	2017年度 予想	2018年度 マイルストーン		2020年度 中計目標	目指す 水準
営業利益	386億円	370億円	350億円		> 400億円	
当期純利益	176億円	200億円			> 200億円	
D/Eレシオ	1.22	1.29				< 1.0
ネットD/Eレシオ	0.99	1.06				< 0.8
自己資本比率	27.6%	27.8%				> 30%
ROE	9.3%	9.5%			> 8%	> 10%

○ 事業の強化と変革

○ グローバル市場での拡販推進

○ 新事業の開拓加速



収益性向上

製品群ポートフォリオ見直しに
「事業資産営業利益率」を活用

グローバル化

新事業創出

■ 課題事業：電力、銅条事業

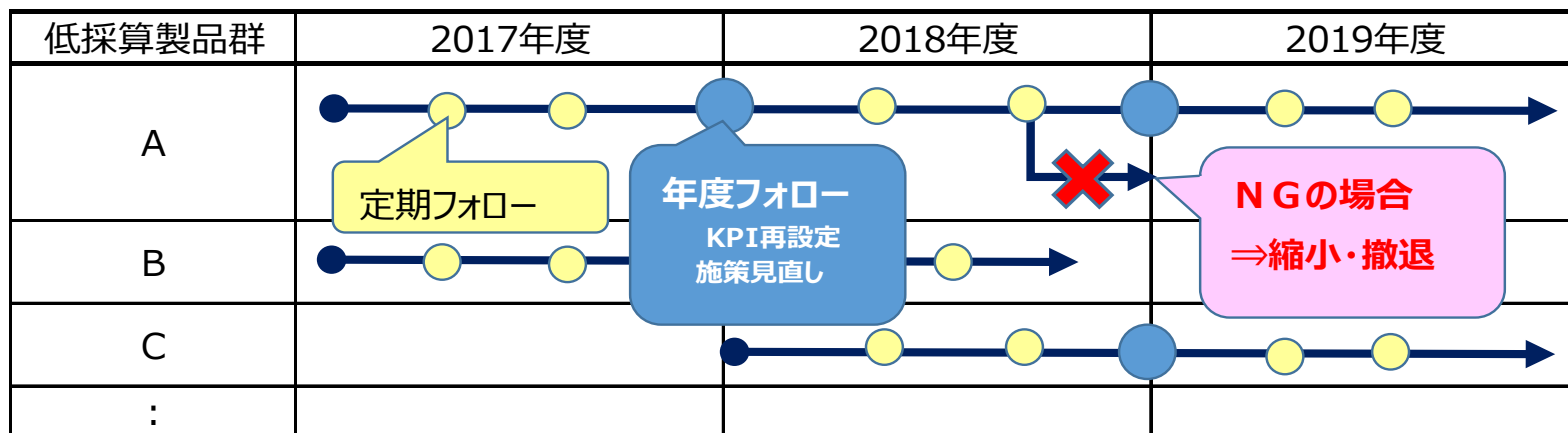
電力は体制の再構築、銅条は製品ミックス改善・車載向け増販で収益を改善

■ 低採算製品群：

事業資産営業利益率の導入により、製品群毎の収益ターゲットと時間軸を
見える化して改善のスピードを向上

	2015年度実績	2016年度実績	2017年度予想
事業資産 営業利益率	9.1%	12.1%	11.1%
営業利益	271億円	386億円	370億円
事業資産	2,982億円	3,196億円	3,335億円

施策フォロー手順

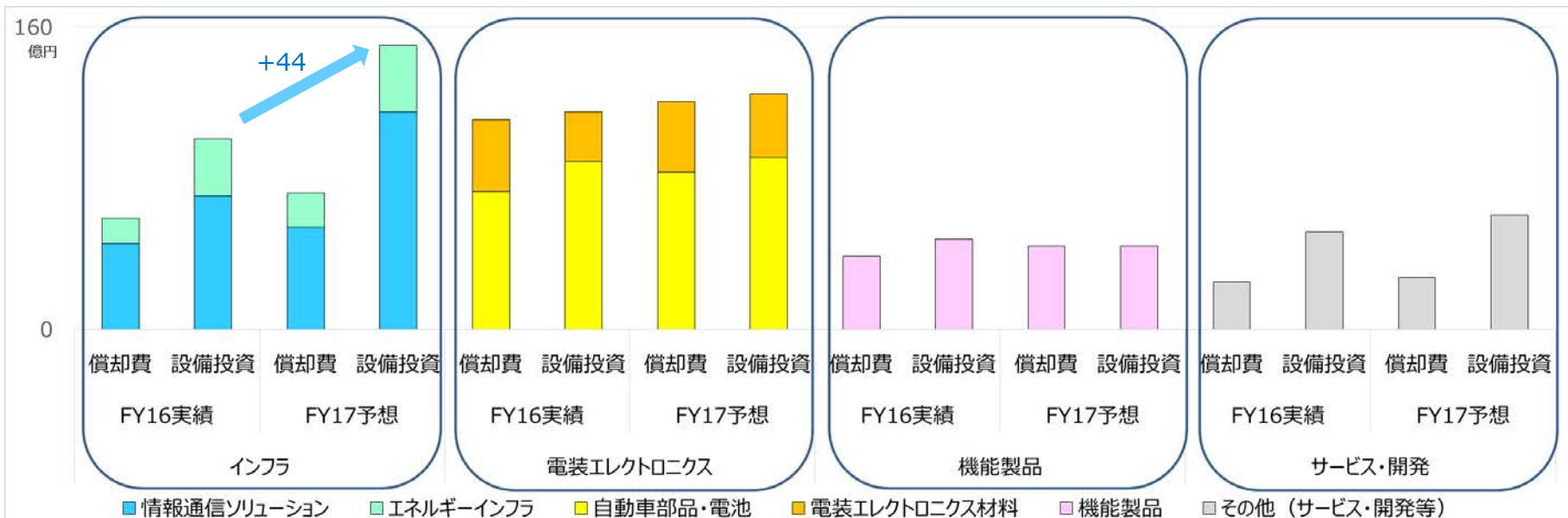


Ⅱ. 成長分野への投資拡大

ー インフラ、自動車分野を中心に、設備投資を拡大

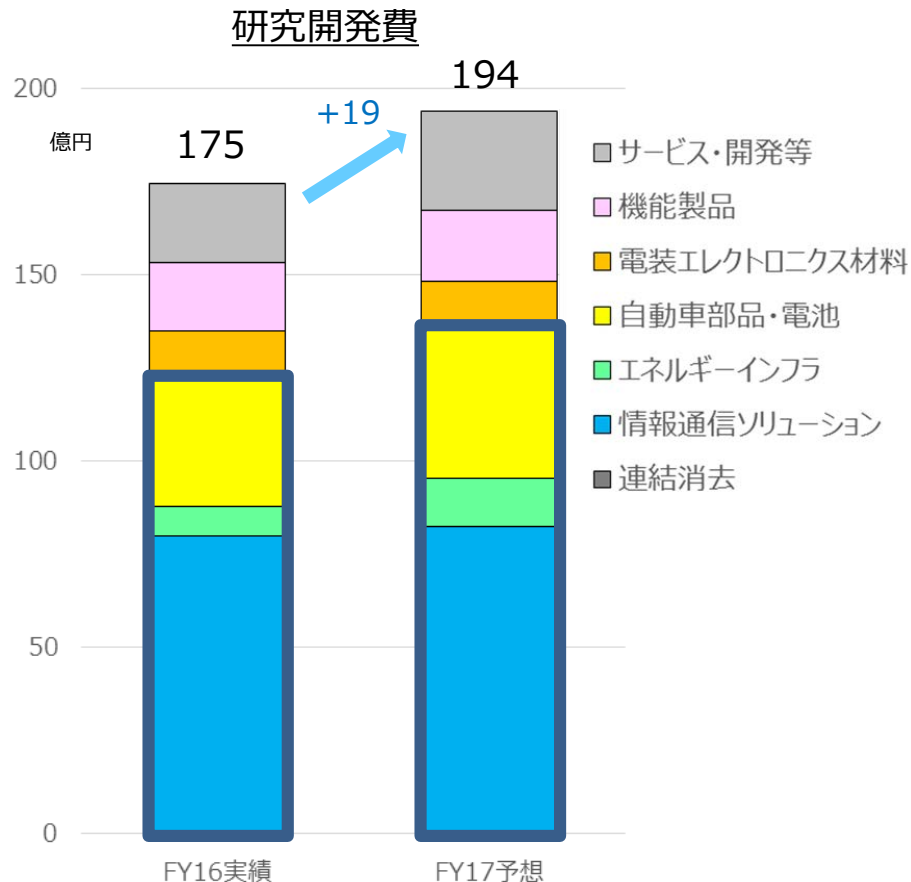
(16年度 316億円 ⇒ 17年度 380億円 +64億円)

- ・ 情報通信 : 需要拡大に合わせた光ファイバ及び光部品の増産
- ・ エネルギーインフラ : 電力事業新体制のもと、市場要求に応える生産体制を構築
- ・ 自動車部品 : 周辺監視レーダなど部品事業の増産対応
- ・ 電装エレクトロニクス材料 : 製品ミックス改善と車載関連市場向け対応
- ・ 機能製品 : 顧客要求の変化に合わせた製品の高度化対応
- ・ サービス・開発 : グループ・グローバル連携、エリア戦略強化のためのシステム拡充

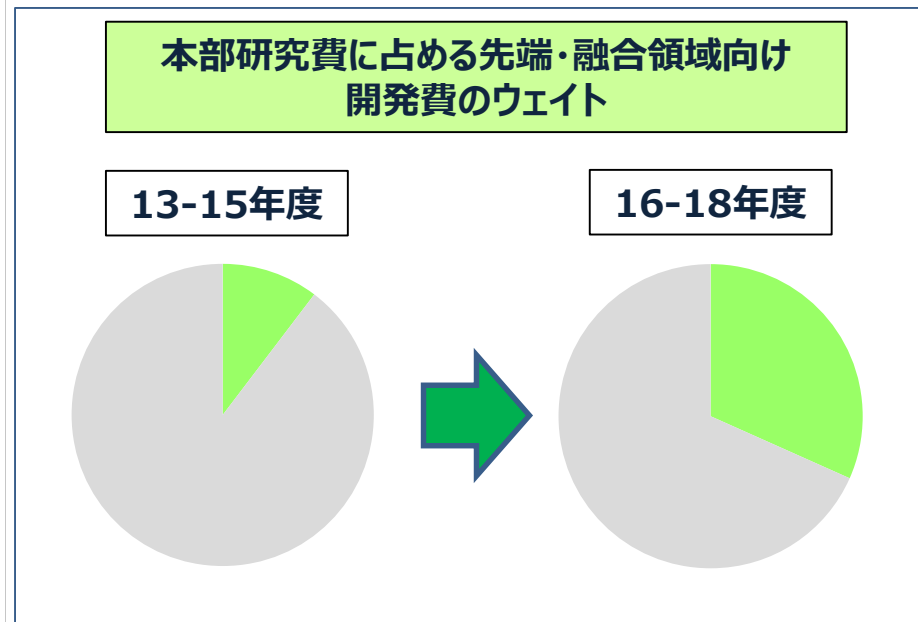


ー 通信インフラの高速・大容量化、自動車のグリーン化に応える開発投資を強化

- ・ 情報通信 : 光ファイバ及び光部品 高付加価値製品対応
- ・ 自動車部品 : 自動運転・電動化に向けた部品事業



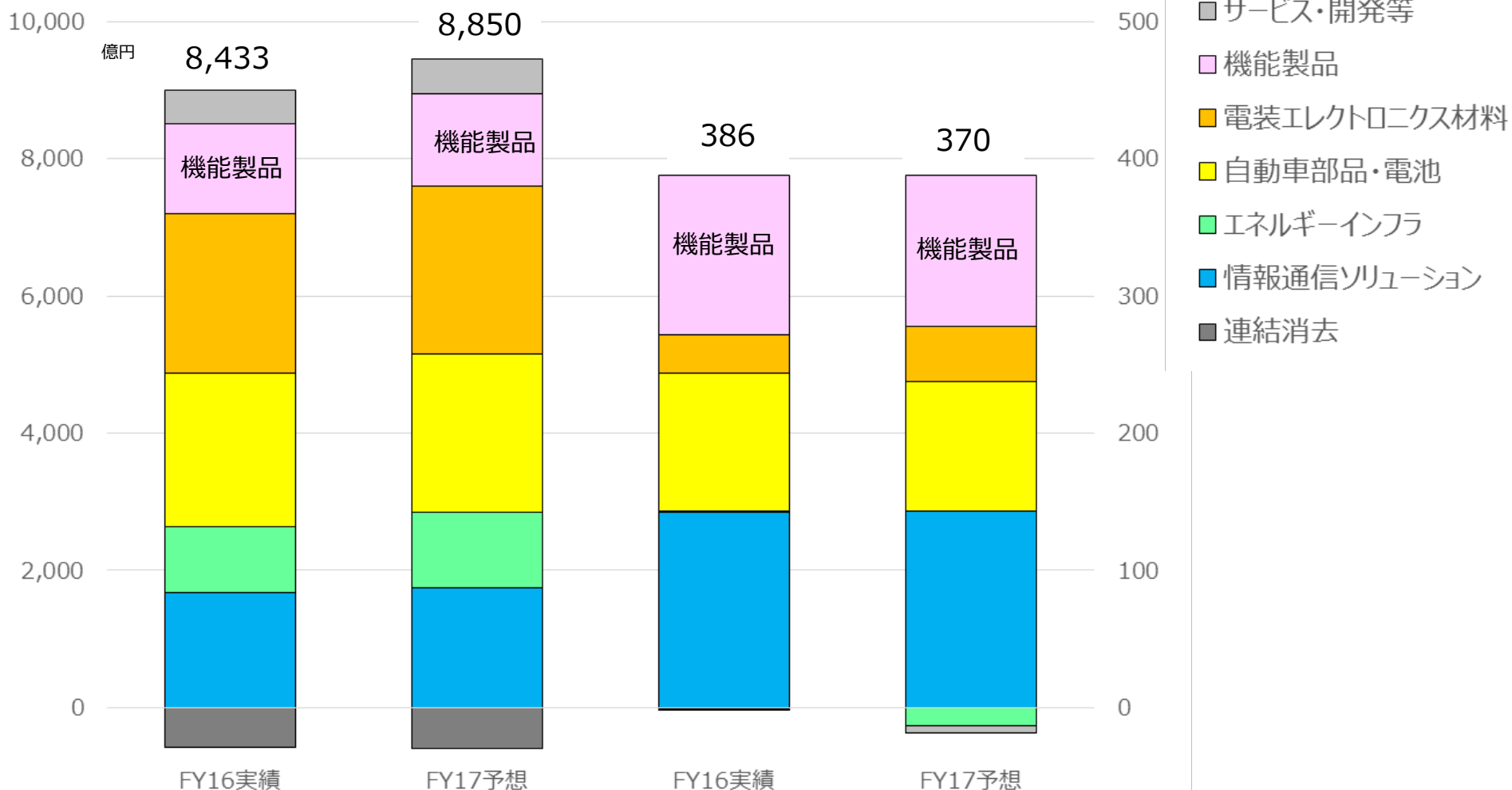
ー インフラ・自動車の融合領域進展による事業機会の拡大を見据えた開発体制も強化



IV.機能製品セグメント – 売上高・営業利益

売上高

営業利益



IV.機能製品セグメント - 概要

事業	主要製品	用途	現状	「利益最大化のための」戦略
A T・機能樹脂	<ul style="list-style-type: none"> 半導体製造用テープ  <p>AT : Advanced Technology Tape</p>	<ul style="list-style-type: none"> 半導体ウエハの加工工程での、表面保護や固定など フラッシュメモリ内での半導体チップ積層 	<ul style="list-style-type: none"> 海外売上比率 9割 	<ul style="list-style-type: none"> 顧客の製造プロセス変更へのスピーディーな対応や、製造プロセスそのものの提案 例：17年3月1日リリース 「レーザー溝加工+プラズマダイシング工法向け新型半導体用テープの開発に成功」
	<ul style="list-style-type: none"> ケーブル保護管 断熱材 	<ul style="list-style-type: none"> 地中埋設ケーブルの保護管 空調配管用断熱材 	<ul style="list-style-type: none"> 国内シェア5割強 (ケーブル保護管) 国内シェア5割弱 (空調配管用断熱材) 	<ul style="list-style-type: none"> 拡大が予想される電線地中化市場への展開 空調配管用顧客への関連商材展開
銅箔	<ul style="list-style-type: none"> 回路用電解銅箔 	<ul style="list-style-type: none"> リジッド基板 F P C 	<ul style="list-style-type: none"> 台湾への製造集約完了 (重量ベース 台湾：日本=5：1) 	<ul style="list-style-type: none"> 付加価値品の拡大 【回路用】 フレキシブル箔 ⇒ スマートフォン 高周波用箔 ⇒ 高速サーバー 【電池用】 薄箔、高強度箔 ⇒大容量リチウム電池
	<ul style="list-style-type: none"> 車載電池用電解銅箔 	<ul style="list-style-type: none"> 車載リチウム電池の負極材 	<ul style="list-style-type: none"> 車載リチウム電池用でトップレベル 	
	<ul style="list-style-type: none"> 民生電池用電解銅箔 	<ul style="list-style-type: none"> PC・スマホなど民生用リチウム電池の負極材 		
サーマル・電子	<ul style="list-style-type: none"> 銅/アルミ製のヒートシンク、ヒートパイプ 	<ul style="list-style-type: none"> CPUやパワー半導体、電子部品、高出力LED照明などの放熱・冷却 	<ul style="list-style-type: none"> 売上構成比 FY16→FY17 PC 5割→4割 データセンタ 2割→3割 	<ul style="list-style-type: none"> データセンター分野におけるトップサプライヤとしての地位確立。高出力半導体分野への拡販。
メモリスクリ	<ul style="list-style-type: none"> HDD用アルミblank材 	<ul style="list-style-type: none"> PCやデータセンタのHDD 	<ul style="list-style-type: none"> 世界シェア4割 売上構成比 PC 4割, データセンタ6割 	<ul style="list-style-type: none"> UACJとの合併会社を軸に、開発提案力・品質改善力を強化。データセンタ用途で更なるシェア拡大。

※その他：東京特殊電線、FCM、販社 など

ご清聴ありがとうございました。

Bound to  *Innovate*